

无铅助焊剂/免清洗助焊剂

产品名称	无铅助焊剂/免清洗助焊剂
公司名称	成都市鼎创精工科技有限公司
价格	350.00/桶(25升)
规格参数	包装规格:25升/桶 型号:HC-901 用途:电子行业锡焊焊接
公司地址	郫县安靖镇方碑村二社.十社府河御景2幢1楼11号
联系电话	028-64143465 18080058246

产品详情

无铅助焊剂应用：

针对电子无铅焊接制程，适用于电源产品、通讯产品、医疗设备、仪器设备、电视机、音响设备、家用电器、电脑产品等PCB板的焊接，及其它要求质量可靠度很高的产品。

无铅助焊剂特点：

本品属于无铅环保型免洗助焊剂。
不会破坏臭氧层，不含ODS物质。 很好的焊接性能，较低的缺陷率。
焊后焊点饱满，且焊接烟雾小。 焊后表面残余物较少并且均匀。 残余物无腐蚀，不粘手。
耐热性好，在双波制程中有优良的表现。

无铅助焊剂的操作：

本产品可应用手浸、波峰、发泡、喷雾等方式的焊接工艺。过锡后的PC板零件面与焊接面必须干燥，不可有液体状的残留。手动手浸焊，过锡的速度3-5秒，焊接面与零件面不可有液体。助焊剂发泡作业或手浸作业，本剂比重必须控制在标准比重范围（0.795-0.815）之间。当PC板氧化严重时，请予以焊前适当处理，以确保焊接质量。发泡式：发泡石的细孔开口应该用0.005-0.01mm(5-10microns)之间的发泡孔。为了维持适当的发泡效果,助焊剂至少要比发泡石高出一英寸(25mm)以上的高度。喷雾式：喷雾时须注意喷嘴的调整,务必让助焊剂均匀分布在PC板上。调整风刀风口应按发泡槽的方向，风口的适当角度为15度（以垂直角度计）。预热温度：90-115 之间。转动带速度：可介入每分钟1.2-1.5米之间。

无铅助焊剂技术说明：(编号:HC-901)项目	规格/Specs	参考标准
扩散率%	92%	IPC-TM
卤素含量%	无	比重（30

铜镜测试	通过) 焊接预热温 度
绝缘阻抗值	1.0×10^9	IPC-TM
水萃取液电阻率	5.0×10^4	IPC-TM
固态成份%	$2.9 \pm 0.5\%$	IPC-TM
焊点色度	光亮型	IPC-TM